

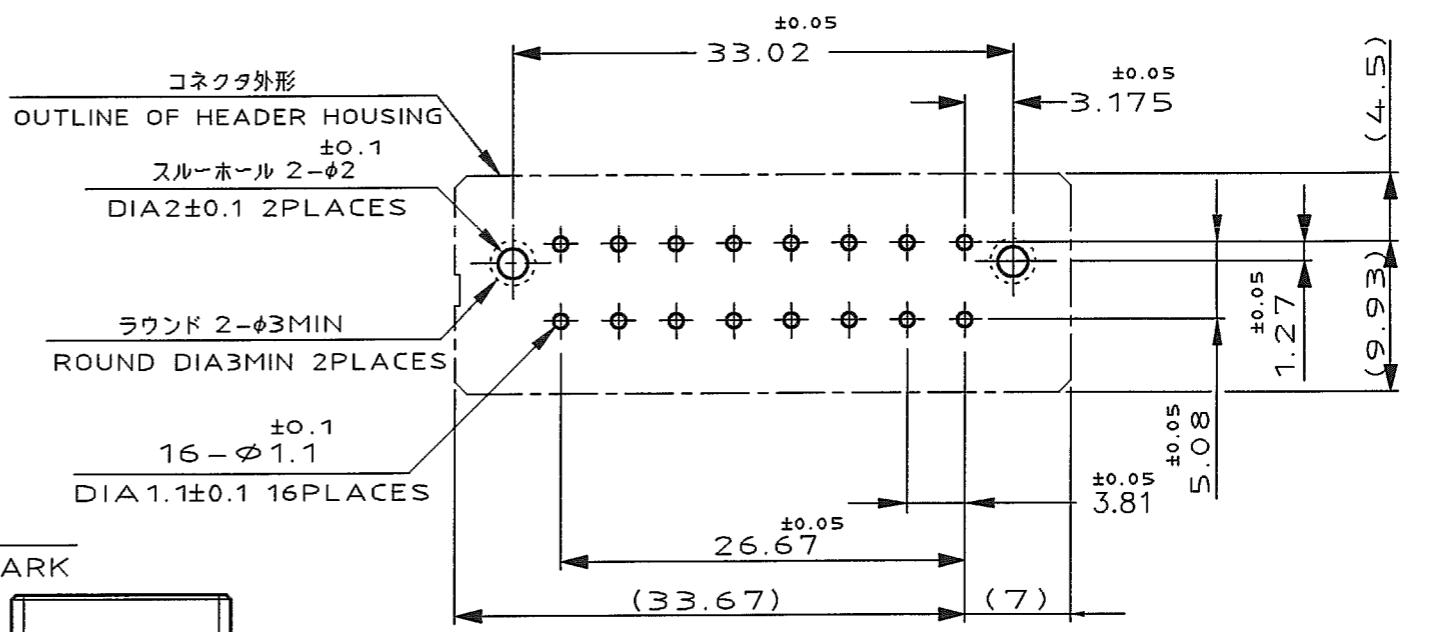
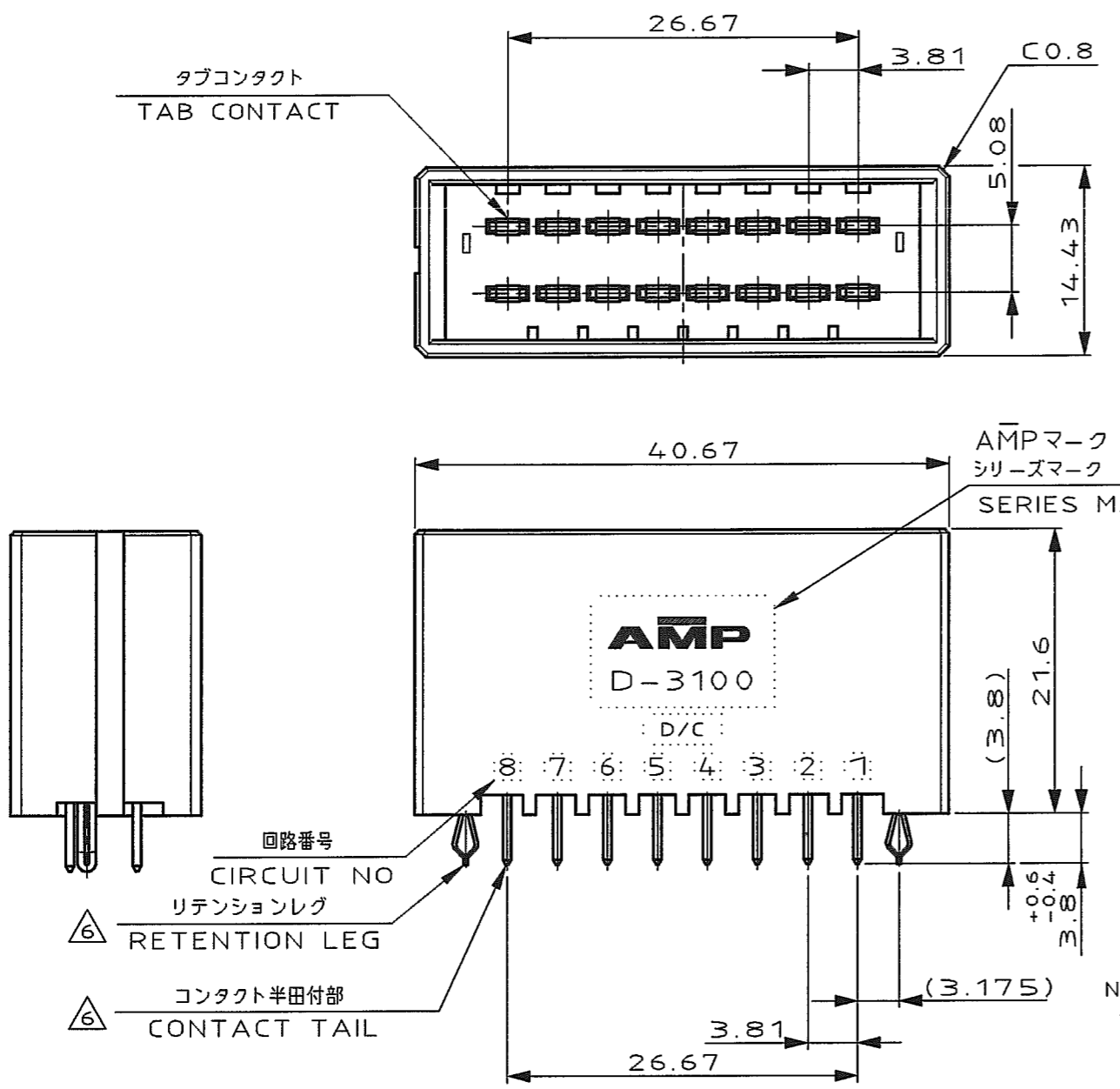
NUMBER 178327



METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST



推奨基板取付け寸法
PC 基板厚: 1.6±0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN
PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER (94V-0), COLOR: BLACK
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- FINISH (CONTACT AREA): 0.38μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 0.76μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂 (94V-0), 色: 黒
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38μm MIN金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76μm MIN金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MINスズめっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の上に半田めっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の上にスズめっき

△6	△4	178327-5
△6	△3	178327-3
△6	△2	178327-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)

REV	DESCRIPTION	DATE	BY	CHK
E	REVISED	FJDO-0039-03	T.S.S.M.	8/2
D	REVISED	FJDO-0114-03	T.S.S.M.	25.APR '93
C	REVISED	FJ00-2744-95	KI.Y.I.	16/JUN '95
B	REVISED	FJ00-0838-94	NM.S.M.	7/4 '94
A	REDRAWN WITH CHANGE	FJ00-0480-94	NM.S.M.	4/20 '94
LTR	REVISION RECORD		DR	CHK DATE

Copyright © 1994 AMP(Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.	
WIRE RANGE mm²(AWG -)	INSULATION DIA mmφ
MATERIAL SEE NOTE 注記参照	FINISH SEE NOTE 注記参照
DR. 19 APR 94 N.Matsubara	DE. 19 APR 94 N.Matsubara
CHK. S.MANABE	APP. S.MANABE

NAME 16 POS DOUBLE ROW VERTICAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC D-3100			
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	SIZE	LOC	NUMBER
10mmF : ±0.3 30mmF : ±0.4 30mmF100mmF : ±0.45 角 度 : ±3'	A3	J	C=178327
SCALE	REV.	SHEET	
2-1	E	1 OF 1	